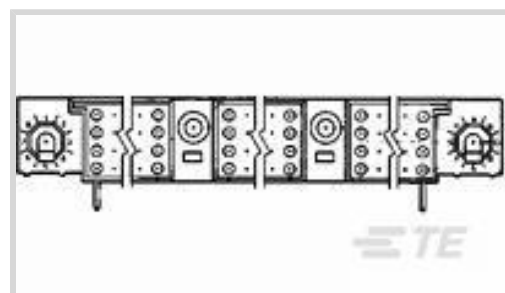


## AMP-HDI

TE 内部编号 5532840-2

PCB Mount Receptacle, Right Angle, Board-to-Board, 540 Position,  
2.54 mm [.1 in] Centerline, Gold, Through Hole - Solder, Signal,  
Black, Tube

[在 TE 官网查看>](#)

[连接器](#) > [PCB 连接器](#) > [PCB 板端连接器及母端](#)


连接器系统: 板对板

位数: 540

行数: 4

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装方向: 直角

## 产品特性

### 产品类型特性

|             |          |
|-------------|----------|
| 连接器系统       | 板对板      |
| 可密封         | 否        |
| 连接器和端子端接到   | 印刷电路板    |
| PCB 连接器组件类型 | PCB 安装母端 |

### 结构特性

|          |     |
|----------|-----|
| 可堆叠      | 否   |
| 位数       | 540 |
| 行数       | 4   |
| PCB 安装方向 | 直角  |

### 电气特征

|      |      |
|------|------|
| 绝缘电阻 | 4 MΩ |
|------|------|

### 主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

### 接触件特性

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度 | .1 μm[3.937 μin]    |
| 端子布局             | 矩阵                  |
| 端子接合区域电镀材料厚度     | .76 μm[29.9212 μin] |
| 端子形状和构造          | 四梁                  |



|                |     |
|----------------|-----|
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡   |
| 端子基材           | 铜合金 |
| 端子接触部电镀材料      | 金   |
| 端子类型           | 插座  |
| 端子额定电流（最大值）    | 3 A |

#### 端接特性

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 矩形端接柱体和尾部厚度 | .25 mm[.01 in]  |
| 矩形端接柱体和尾部宽度 | .58 mm[.023 in] |
| 端接柱体和尾部长度的  | 4.57 mm[.18 in] |
| PCB 端接方法    | 通孔 - 焊接         |

#### 机械附件

|          |     |
|----------|-----|
| 接合对准类型   | 键控  |
| 连接器安装类型  | 板安装 |
| 接合对准     | 带有  |
| PCB 安装对准 | 不带  |
| PCB 安装固定 | 不带  |

#### 壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 外壳材料    | 热塑性            |
| 中心线（间距） | 2.54 mm[.1 in] |

#### 尺寸

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 连接器高度      | 11.02 mm[.433 in] |
| PCB 厚度（建议） | 2.36 mm[.76 in]   |

#### 使用环境

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 壳体温度额定值 | 高                          |
| 工作温度范围  | -65 – 125 °C[-85 – 257 °F] |

#### 操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

#### 行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

#### 包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 1    |
| 封装方法 | Tube |

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|   |   |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料   |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月 (219)<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量  | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。  |
| 焊接工艺能力  | 通孔回流焊可达到 260°C  |

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 客户还购买了





## 文档

### 产品图纸

[ASSY,RECPT,R.ANGLE,HDI,LEAD-FR](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_5532840-2\\_O.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_5532840-2\\_O.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_5532840-2\\_O.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 产品规格

[应用规格](#)

英文版本

### 使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本